

电子

优于大市(维持)

证券分析师

陈海进

资格编号:S0120521120001 邮箱:chenhj3@tebon.com.cn

陈蓉芳

资格编号: S0120522060001 邮箱: chenrf@tebon.com.cn

研究助理

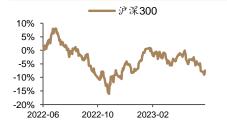
徐巡

邮箱: xuxun@tebon.com.cn

陈妙杨

邮箱: chenmy@tebon.com.cn

市场表现



相关研究

- 1.《电子周观点:苹果 MR 有望发布, 关注 MR/充电桩/手机链 IC》, 2023.6.4
- 2.《茂莱光学(688502.SH): 高端精密 光学厚积薄发, 半导体等下游多重共 振》, 2023.6.1
- 3.《电子周观点:英伟达指引大超预期,算力再迎爆炸时刻》,2023.5.28 4.《海外科技跟踪:模拟芯片巨头亚德诺(ANALOG) Q2 收入增速放缓,行业年内或迎拐点》,2023.5.26
- 5. 《虚拟电厂政策催化,智能电表芯片行业迎机遇》, 2023.5.25

电子周观点:半导体周期望触底,关注消费电 子国产龙头新品机遇

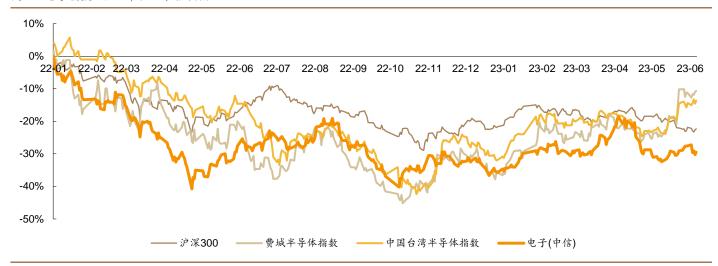
投资要点:

- 半导体大周期拐点临近。本周电子(中信)指数下跌 2.7%,其中半导体板块也有一定下跌。复盘本周行情,算力产业链继续涨幅较好,包括服务器连接线、PCB、Chiplet 等; IC 设计板块有所下跌,可能受到终端需求仍未改善影响。根据 SIA 数据,4月全球半导体销售额 399.5 亿美元,环比+0.3%;中国半导体销售额 114.3 亿美元,环比+2.9%。半导体销售额连续两月环比恢复,且同比降幅停止扩大。我们坚定看好下半年半导体周期的修复,逻辑在于: 1)下半年终端新品发布,如高通 8gen3 芯片有望在 Q4 发布并预计带动手机需求回暖。2) 半导体销售额从 22年中开始走弱,23H2 基数开始明显下降。建议关注: 1)封测: 封测厂商稼动率 Q2有望开始好转,且台系封测厂营收已经在 Q1 触底。同时,Chiplet 等先进封装有望巩固头部封测厂的壁垒以及提升封测价值量。建议关注长电科技、通富微电、华天科技等。2) 存储: 存储核心逻辑在于价格触底+国产化率的提升。6月8日,据台湾电子时报报道,三星计划提高 NAND 晶圆价格。这是继长存之后,另一家大厂也开始对 NAND 涨价。建议关注:东芯股份、兆易创新等。
- 汽车电子:特斯拉 FSD 开放,中国 L3 自动驾驶标准预计发布。特斯拉美股连涨 11 日,5 月 FSD 版本已升级至 11.4.2,且其首次路测智能驾驶功能超越以往。6 月马斯克宣布重磅消息,特斯拉的自动驾驶技术 FSD 将会开放给其他汽车制造商使用,车企智能化之争焦灼。6.9 日华为余承东表示,中国 L3 自动驾驶标准预计6 月底发布,国内智能驾驶再进一程。国常会提出延续和优化新能源车购置税减免政策,汽车电子回温优先关注特斯拉产业链:东山精密/瑞可达/联创电子;智能化硬件关注长光华芯/炬光科技/永新光学/电连技术。
- 消费电子国产龙头产业链:终端新品望拉动上游供应链。下半年,消费电子龙头公司有望发布新款手机从而拉动上游产业链公司。建议关注:华力创通:主营卫星通信芯片与模块,竞争壁垒高。美芯晟:无线充电芯片国内技术领先,跟随大客户逐步上量。力芯微:电源管理芯片受益于大客户拉货,且数字雷管保持快速成长。利和兴:公司产品包括手机测试设备,有望受益于消费电子客户新产品需求。唯捷创芯:LPAMiD产品今年量产导入客户,叠加LPAMiF具备打包销售能力。
- 风险提示: 下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。



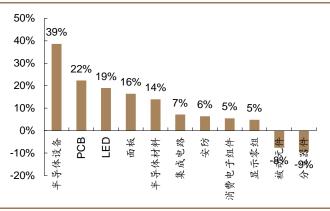
电子板块本周行情一览

图 1: 电子指数 2022 年初以来涨跌幅



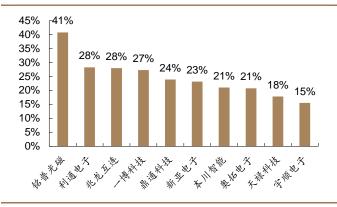
资料来源: Wind、德邦研究所

图 2: 今年初以来电子各子版块股价表现



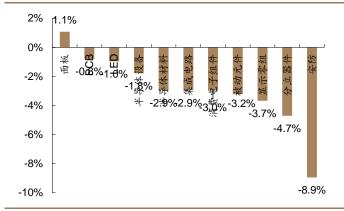
资料来源: Wind、德邦研究所; 备注: 使用中信电子三级行业指数

图 4: 本周电子板块涨跌幅前十股票



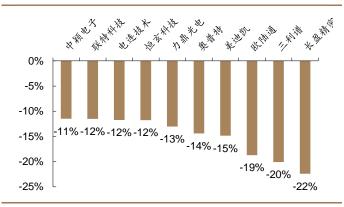
资料来源: Wind、德邦研究所; 备注: 参考中信电子指数成分股

图 3: 本周电子各子版块股价表现



资料来源: Wind、德邦研究所; 备注: 使用中信电子三级行业指数

图 5: 本周电子板块涨跌幅后十股票



资料来源: Wind、德邦研究所; 备注: 参考中信电子指数成分股



信息披露

分析师与研究助理简介

陈海进, 电子行业首席分析师, 6年以上电子行业研究经验, 曾任职于民生证券、方正证券、中欧基金等, 南开大学国际经济研究所硕士。电子行业全领域覆盖。

陈蓉芳,电子行业研究助理,曾任职于民生证养、国金证券,香港中文大学硕士,覆盖汽车电子、车载半导体等领域。

徐巡, 电子行业研究助理, 上海交通大学经济学硕士, 2年以上电子行业研究经验, 曾任职于凯盛研究院, 覆盖 IC 设计、半导体设备与制造等领域。

陈妙杨, 电子行业研究助理, 上海财经大学金融硕士, 覆盖 PCB、面板、LED 等领域。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

投资评级说明

1.	投资证	平级的	比较和	评级相	示准:
以扎	及告发右	市后的	6个月	内的下	市场表
现为	为比较材	示准,	报告发	布日月	台6个
月卢	内的公司	同股价	(或行	业指数	放)的
涨路	失幅相又	计同期	市场基	准指数	负的涨
跌点	畐;				

2. 市场基准指数的比较标准:

A股市场以上证综指或深证成指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。

类 别	评 级	说明		
	买入	相对强于市场表现 20%以上;		
股票投资评	増持	相对强于市场表现 5%~20%;		
级	中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动;		
	减持	相对弱于市场表现 5%以下。		
	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;		
行业投资评	中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;		
級	弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。		

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司(以下简称"本公司")的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险,投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下,德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送,未经德邦证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容,务必联络德邦证券研究所并获得许可,并需注明出处为德邦证券研究所,且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可,德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。